

■第3回電子デバイスフォーラム京都プログラム

(敬称略) 20160820

11月1日(火)10:00-12:40	コース	11月1日(火)14:00-16:50	11月2日(水)10:30-13:00	11月2日(水)14:00-16:50
<p>K-1 挨拶・基調講演 10:00-12:40</p> <p>◆来賓挨拶 京都府知事 山田 啓二(予定) 京都市長 門川 大作(予定)</p> <p>◆基調講演 「IoT機器を支える超小型電子部品」 ㈱村田製作所 取締役常務執行役員 技術・事業開発本部 本部長 岩坪 浩</p> <p>◆基調講演 「IoT革命がもたらす電子デバイスの新世界 ～メモリー半導体とセンサーが急上昇～」 ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉</p> <p>◆基調講演 「New Era of Electrification and Vehicle Intelligence」 日産自動車㈱ フェロー 久村 春芳</p>	<p>【A】次世代自動車</p> <p>【B】電子部品から見た最新IoT/M2M機器</p> <p>【C】次世代成長アプリとそれに搭載される電子デバイス</p>	<p>A-1 ここまで来たADAS/自動運転 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープ)</p> <p>◆次世代自動車へ向けた電子制御システム、自動運転への取組(仮) マツダ㈱ 統合制御システム開発本部 副本部長 山崎 雅史 ◆自動運転自動車のセンシング技術及び珠洲市公道実証実験について 金沢大学 新学術創生研究機構 未来社会創造研究コア 自動運転ユニットユニットリーダー 准教授 菅沼 直樹 ◆自動車の安心安全を実現する車載カメラ外界認識システム ㈱日立製作所 研究開発グループ 技術戦略室 戦略統括センター ストラテジースタッフ 村松 彰二</p> <p>B-1 IoT/M2M機器とそれを支える電子部品 山本浩之(マイクロン)/中村孝(ローム)</p> <p>◆コネクタフリーが描くIoTによって齎される未来とその実現に必要な電子部品への期待(仮題) コネクタフリー 代表取締役総合開発責任者兼CEO テト クリストファー ◆半導体製造装置へのIoTの技術応用 ㈱SCREENセレクトロニクス Group Vice President TS製品 統轄部副統轄部長 兼 CTO室 副室長 ヘチェルスキー・チャールズ ◆電子部品の栄枯盛衰(「マイロセンサ」事業20年間の振り返りから) ㈱村田製作所 新規・事業開発本部 新規技術センター デバイス開発部 シニアエキスパート 藤本 克己</p> <p>C-1 メディカル・ヘルスケア 泉谷渉(産業タイムズ社)/中村孝(ローム)</p> <p>◆医療・ヘルスケア分野におけるモバイルデバイスの利活用の現状と新たな応用可能性・ビジネス展開 (公財)医療機器センター 医療機器産業研究所 調査研究室 室長 主任研究員 鈴木 孝司 ◆ヘルスケアの深化をデザインする(仮題) シスメックス㈱ 取締役 常務執行役員 浅野 薫 ◆SiC-MOSFETによる高出力小型加速器技術の適用事例 ～BNCT(ホウ素中性子捕捉療法)への適用～ 福島SiC応用技術㈱ 代表取締役社長 古久保 雄二</p>	<p>A-2 次世代電動車を導く先端パワー半導体 佐藤高史(京都大学)/松浦正純(ルネサス)</p> <p>◆SiCトレンチMOS & DTMOS(仮題) ㈱東芝 研究開発センター 電子デバイスラボトリー 四戸 孝 ◆SiCパワーデバイスの進展とその応用 ローム㈱ 研究開発部 部長 中村 孝 ◆次世代パワー半導体(仮題) インフィニオンテクノロジーズジャパン㈱ 藤原エミリオ</p> <p>B-2 センシング技術 宮崎信(村田製作所)/小田川明弘(パナソニック)</p> <p>◆IoT活用に向けた人状態センシング技術(仮題) パナソニック㈱ AIS社 技術本部 センシングソリューションセンター センシングシステム部 開発2課 課長 楠亀 弘一 ◆IoT社会実現のためのMEMSセンシングデバイス オムロン㈱ 事業開発本部 マイクロデバイス事業推進部 商品開発部 商品企画課 経営基幹職 細谷 克己 ◆IoT社会に向けたプリンタブルエレクトロニクスの研究動向(仮題) 大阪大学 産業科学研究所 先端実装材料 教授 菅沼 克昭</p> <p>C-2 ヒトに役立つロボティクス 戸所義博(奈良先端大)/中村行宏(京都情報大学院大学)</p> <p>◆生活を支援するロボット研究-人とロボットが協働する社会に向けて- 奈良先端技術大学院大学 情報科学研究科 研究科長 教授 小笠原 司 ◆産業用ロボットの変遷と将来 ㈱安川電機 技術開発本部開発研究所 ロボティクス技術部 次世代ロボット制御課 課長 安藤 慎吾 ◆世界中の人々に笑顔と元気を届けたい ～玉乗り型ロボット「村田製作所チアリーディング部」の開発～ ㈱村田製作所 広報室 企業広報課 マネージャー 吉川 浩一</p>	<p>A-3 自動車が牽引する次世代実装技術 中村孝(ローム)/宮崎信(村田製作所)</p> <p>◆パワーモジュール用高熱伝導性絶縁材料 三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 パワーモジュール開発プロジェクト グループ パッケージング技術グループ マネージャー 平松 星紀 ◆パワーモジュール(仮題) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第2事業所 先進 パワーエレクトロニクス研究センター 副研究センター長 山口 浩 ◆車載特有の半導体実装技術動向と次世代自動車に向けた実装技術 ㈱デンソー 半導体実装開発部第2PF開発室 担当次長 大竹 精一郎</p> <p>B-3 先端材料・デバイス 芳賀恒之(NTT)/雲梯隆夫(UNATE)</p> <p>◆新しいタイプの真空管「Nutube」について-なぜ今、真空管なのか- ㈱コルグ 開発2部AR開発グループ 森川 悠佑 ◆ふるなび(仮題) 日本電信電話㈱ コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 感覚運動研究グループ 五味 裕章 ◆形状記憶合金ワイヤの微小振動を用いた触感提示と触覚ディスプレイへの応用 香川大学 工学部 知能機械システム工学科 教授 澤田 秀之</p> <p>C-3 マーケティング 泉谷渉、松下晋司(産業タイムズ社)</p> <p>◆司会進行/総論 ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉 ◆2017/エレクトロニクス産業と半導体需要の展望(仮題) IHSグローバル㈱ 日本調査部ディレクター 主席アナリスト IHSテクノロジ 南川 明 ◆電子部品業界/市場動向と進化の方向性 ㈱産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 編集長 補佐 松下 晋司 ◆揺れるFPD業界、OLED vs LCD、Samsung vs 中国、新技術台頭の 可能性? 日本企業の立ち位置は? みずほ証券㈱ リサーチグループ エキイティ調査部 グローバル・ ヘッド・オブ・テクノロジ・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫</p>
<p><注> (1)「C-3 マーケティング」は、各産業の第一線のアナリストをお招きし、泉谷渉(NEDIA理事・副会長、 ㈱産業タイムズ社代表取締役社長)の司会による、 エレクトロニクス産業・半導体産業・電子部品産業・ 液晶産業を網羅したパネルディスカッション形式で 行います。</p> <p>【D】チュートリアル①</p> <p>【E】チュートリアル② スマホ・ウェアラブル機器に 最適な先端超小型電子 部品の現状</p>	<p>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム ～最新解析技術と活用事例～ 戸所義博(奈良先端大)</p> <p>◆最先端のデバイス・材料開発を支援する分析・解析技術 ㈱東レリサーチセンター 総合企画室 主席部員 杉山 直之 ◆ナノテクノロジープラットフォーム利用事例 ・ミストCVDを用いた酸化ガリウムパワーデバイス(世界最小オン抵抗 抗ダイオード)の開発(仮題) ㈱FLOFSIA 取締役 織田 真也 ・ナノ多孔性セラミック分離膜基盤を活用した化学産業の省エネ・ グリーン化 イーセップ㈱ 代表取締役社長 澤村 健一 ・測域センサ用途における面発光レーザー(VGSEL)の採用検討評価と劣化 特性解析 北陽電機㈱ 品質保証部品質保証課 係長 堀田 勝之</p> <p>E-1 超小型部品を支える最新材料・装置 藤原健典(東レ)/不破保博(ローム)/岡田吉生(GF)/山本浩之(マイクロン)</p> <p>◆ファンアウト再配線材料の開発状況 東レ㈱ 電子情報材料研究所 リサーチフェロー/工務技監 富川 真佐夫 ◆ますます進化する半導体パッケージを支える実装材料技術 日立化成㈱ 開発統括本部 パッケージングソリューションセンター 主管研究員 高野 希 ◆ウエハ仮貼り合わせ/剥離技術の最新動向 ズース・マイクロテック㈱ ボンダー部門 部長 石田 博之</p>	<p>D-2 今さら聞けない半導体基礎講座① 廣田良浩(東京エレクトロン)/酒井滋樹(日新イオン機器)</p> <p>◆半導体のできるまで ～半導体デバイス・プロセスの基礎～ ウエストブレイン 代表 西久保 靖彦</p> <p>◆FOWLPデバイスの技術動向(仮題) ㈱東芝 ストレージ&デバイスソリューション社 メモリ事業部 メモリパッケージ開発部 主幹 江澤 弘和 ◆業界最小クラス、小型面実装Wi-SUNモジュール開発事例 ローム㈱ モジュール生産本部 センサ商品開発部 課長 小宮 邦裕 ◆IoT、ウェアラブルに最適なSiTimeのMEMSタイミングデバイス ㈱メガチップス コーポレートマーケティング室戦略企画部 部長 米田 秀樹 ◆EMI商品説明とノイズ対策事例&測定環境紹介(仮題) ㈱村田製作所 EMI事業部 技術開発統括部 商品開発部 次長 川口 正彦</p>	<p>D-3 今さら聞けない半導体基礎講座②</p> <p>◆プラズマエッチングプロセス技術 東京エレクトロン㈱ 開発・生産本部プロセス開発センター グループリーダー 森本 保 ◆イオン注入・拡散技術 ルネサスエレクトロニクス㈱ 生産本部デバイス開発統括部 プロセス技術部 プロセス技術第一課 技師 山口 直 ◆半導体プロセス技術とデバイス特性 東北大学 未来科学技術共同研究センター 教授 寺本 章伸</p> <p>E-2 超小型モジュール・電子部品</p> <p>E-3 超小型電子部品の最新実装技術 ◆高機能・小型化・低背化が進む半導体パッケージとスマートフォン での適応事例 代表 上田 弘考 ◆次世代実装技術(仮題) ㈱ジェイデバイス 開発センター センター長 大井田 充 ◆多様化する実装要求を実現する世界初「低温・低荷重」 ダメージフリー・フリップチップ接合技術(仮題) コネクテックジャパン㈱ 代表取締役 平田 勝則</p>	